明遠精密
法 人 座 談 會

報告人

董事長　洪本原
技術長　潘彥儒
總經理　焦元煜

2026/11/04

Summary

- 三大半導體業務成長 整體營運審慎樂觀
  - 技術服務　(63%)：持續滿載 隨著全世界半導體廠陸續量產 長期往上
  - 自有品牌　(19%)：a. ACME(RF System) 2026降 => 2027升
    b. MW/RPS/Ozone 小量穩定接單 國產化商機 長期往上
  - 備品與其他(18%)：市場熱絡
- 營運說明

	2025/1~9	2026/1~9	YoY
營收	501M	559M	11%
毛利率	32%	40%	⬆ 8%
營業費用率	22%	20%	⬇ 2%
稅後淨利	45M	103M	129%
稅後EPS	1.35	3.06	127%

- 2026/1-9：
  - ACME 營收減少約50M
  - 技術服務與備品成長約100M
- 先進製程技術服務接單穩定成長
  毛利率重回40%
- 擴產規劃 迎接業務成長

營 運 說 明

公司概況

- 公司成立　：2010/09
- 資本額　：3.38億
- 員工人數　：156人
- 營業據點　：竹北、上海、南科、日本
- 市場定位　：半導體前段製程設備電源部件之技術服務與自有品牌
- 銷售類型　：技術服務63%、自有品牌19%、備品買賣18%
- 近年經營成果：



(NT$)	合併營收	毛利率	稅後淨利	稅後EPS	股本
2022	752M	42%	133M	5.78	243M
2023	728M	39%	103M	3.55	306M
2024	760M	36%	90M	2.91	336M
2025	671M	33%	70M	2.07	338M
2026/Q1	175M	35%	24M	0.70	338M
2026/Q2	195M	41%	42M	1.24	338M
2026/Q3	189M	45%	38M	1.12	338M

經營團隊

職稱	姓名	學歷	主要經歷
榮譽董事長 策略長	寇崇善	UCLA 電機系博士	清大物理系教授 日揚科技執行長
董事長 兼營運長	洪本原	交大 管科系學士	閎康科技 總管理處副總
總經理	焦元煜	成大 復健科學士	新世紀光電 業務處長
技術長 兼日本總經理	潘彥儒	清大 物理系博士	同步輻射中心研究員
上海總經理 (立盈、明遠)	王　征	瀋陽大學 電氣自動化學士	日揚上海工程師 立盈上海課長/經理/副總
研發處協理	陳建勳	清大 材料系博士	日揚科技 研發經理、台積電工程師
技術顧問	曾信華	清大 物理系碩士 交大 生科系博士	台積電 資深工程師 交大 助理教授

重要沿革

技術服務

自有品牌

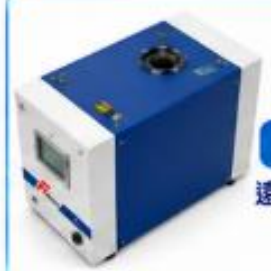
擴產規劃

時間	重要事項
2010	寇崇善博士成立
2013	台灣第一家提供半導體臭氧產生器技術服務公司
2017	● 開發半導體射頻電源系統 命名ACME ● 成為國際半導體設備大廠全球臭氧產生器主要維修供應商與策略夥伴
2019	● 自有品牌ACME(射頻電源系統)通過半導體大廠驗證 正式導入製程設備 ● 自有品牌RPS(遠程電漿源)取得經濟部A+專案開發計畫
2021	● 合併立盈科技 ● 台灣第一家成功開發ALD應用的臭氧供應系統 命名AOS(先進臭氧系統)
2024	● 自有品牌ACME節電效益68% 取得重要客戶的供應商ESG競賽首獎 ● 上櫃 代號7704
2026	● 技術服務：先進製程應用之Ozone/ RPS逐步接單 ● 自有品牌 ：① ACME超過300套；② RPS/ MW/ Ozone小量穩定接單 ● 購置日本福岡廠房 廠房面積約60坪 (地250坪) ● 購置上海青浦廠房 廠房面積約600坪

明遠產品定位：電漿技術應用

反應氣體源

反應氣體源
Reactive Species Sources



RPS
遠端電漿源



Ozone Generator
臭氧產生器

產生活性自由基
Reactive Radicals

O_3 O F N* H*

高活性自由基 /
臭氧等活性自由基

產生高能量
RF / MW Energy

RF Power
(Radio Frequency)

MW Power
(Microwave)

產生高功率電磁能量

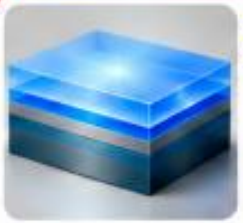
產生電漿
Process Plasma



半導體前段製程應用
Semiconductor Front-End Process



氧化 / 擴散
Oxidation / Diffusion
- 熱氧化 (LOCOS / STI)
- 爐管氧化
- 高濃度臭氧 (O_3)



薄膜沉積 (CVD / ALD)
- 介電層 (SiO_2, SiN)
- High-k / Low-k
- 金屬前驅層
- 表面改質 (RPS / RF / MW / O_3)



電漿蝕刻 (Plasma Etching)
- 介電層蝕刻 (SiO_2, SiN)
- 金屬蝕刻
- 高深寬比結構 (Trench / Via)
- RPS / RF / MW 應用



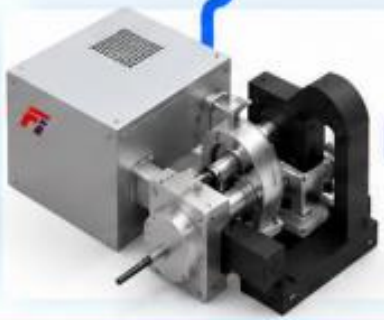
濕式清洗 (Wet Cleaning)
- DiO_3 臭氧水
- 去除有機殘留 (Descum)
- 表面改質 / 活化
- FEOL 前段清洗

功率源

功率電源 Power Sources

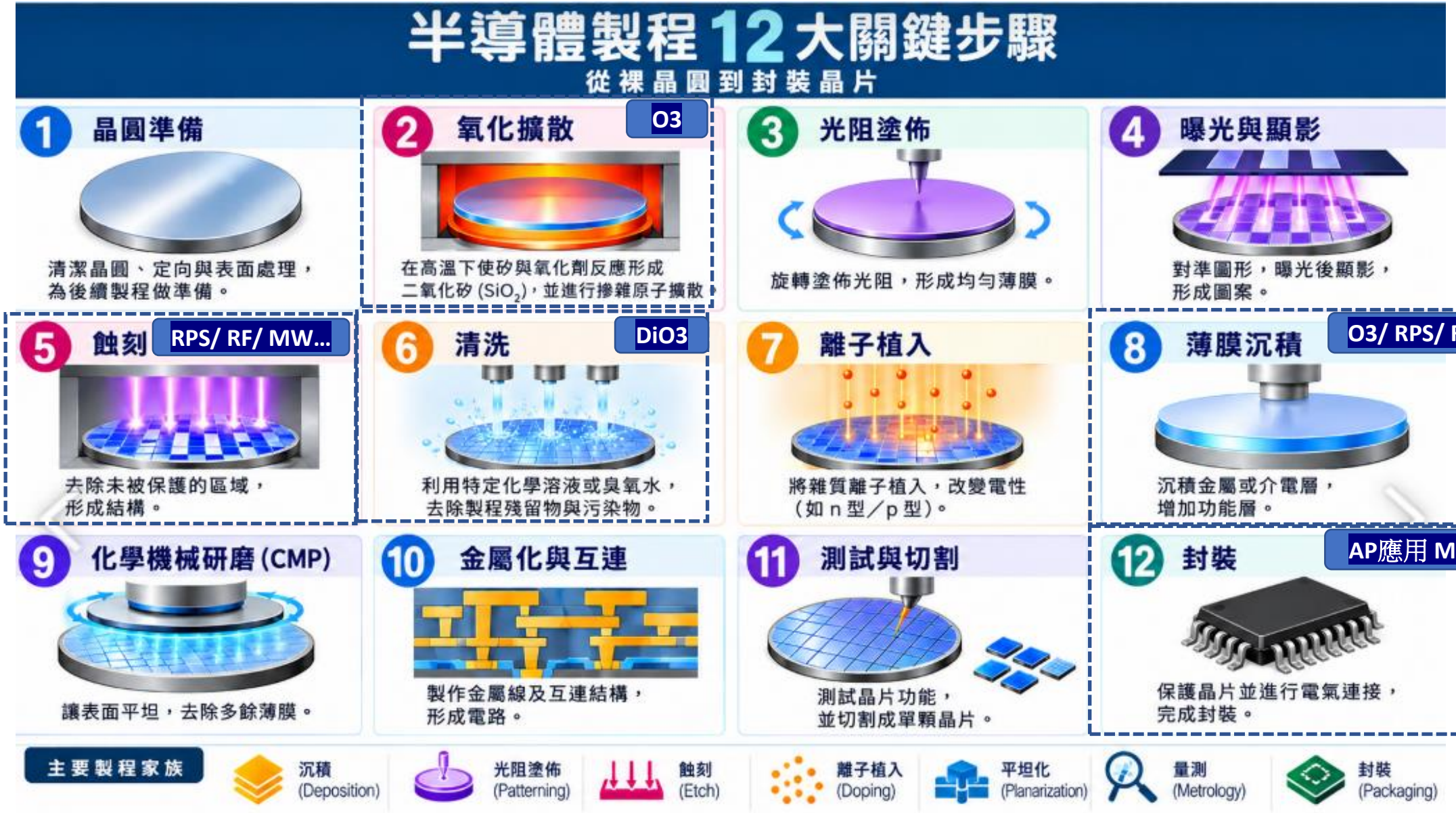


ACME Power Supply
射頻電源

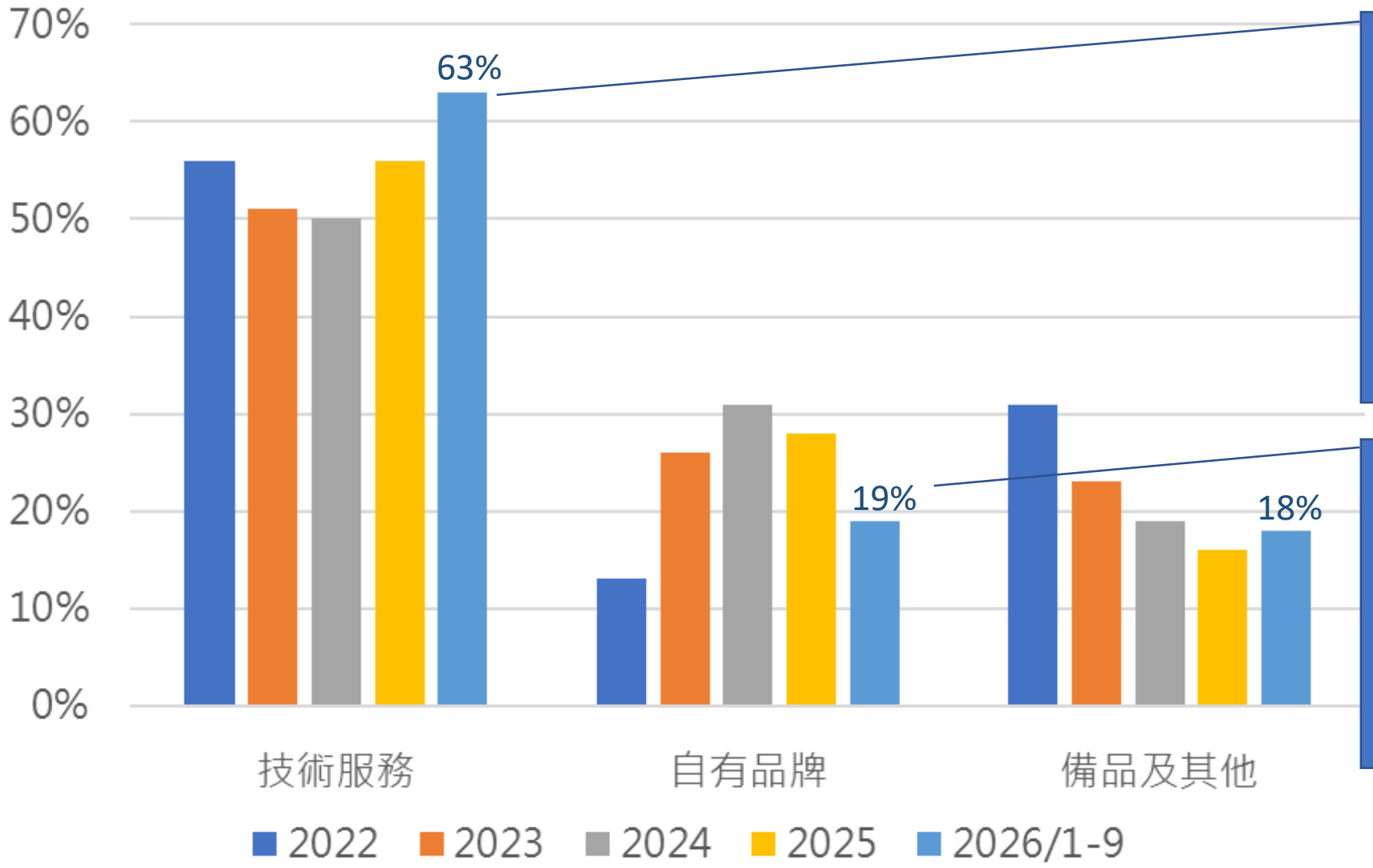


MW Power Supply
微波電源

明遠產品應用


半導體製程12大關鍵步驟
從裸晶圓到封裝晶片
1 晶圓準備
清潔晶圓、定向與表面處理，為後續製程做準備。
2 氧化擴散
O3
在高溫下使矽與氧化劑反應形成二氧化矽 (SiO_2)，並進行摻雜原子擴散。
3 光阻塗佈
旋轉塗佈光阻，形成均勻薄膜。
4 曝光與顯影
對準圖形，曝光後顯影，形成圖案。
5 蝕刻
RPS/ RF/ MW...
去除未被保護的區域，形成結構。
6 清洗
DiO3
利用特定化學溶液或臭氧水，去除製程殘留物與污染物。
7 離子植入
將雜質離子植入，改變電性（如 n 型／p 型）。
8 薄膜沉積
O3/ RPS/ RF/ MW
沉積金屬或介電層，增加功能層。
9 化學機械研磨 (CMP)
讓表面平坦，去除多餘薄膜。
10 金屬化與互連
製作金屬線及互連結構，形成電路。
11 測試與切割
測試晶片功能，並切割成單顆晶片。
12 封裝
AP應用 MW/RPS
保護晶片並進行電氣連接，完成封裝。
主要製程家族
沉積 (Deposition)
光阻塗佈 (Patterning)
蝕刻 (Etch)
離子植入 (Doping)
平坦化 (Planarization)
量測 (Metrology)
封裝 (Packaging)

營業內容



Overhaul Experiences
. O3 > 5,000
. RPS > 20,000
. MW > 15,000
. RFG > 10,000

2026先進製程應用接單
逐步成長

1. ACME
   RF Generators System
2. AOS
   Advanced Ozone System
3. MW/RPS/Ozone
   小量穩定接單

明遠的客戶

	業務型態	趨勢與商機
半導體廠	技術服務	● 橫跨 > 0.25μm ~ < 2nm；涵蓋Ozone、RPS、MW ● Fab新廠量產約3年後 第三方維修角色逐漸顯現 ● 台灣技術服務的高CP值
	自有品牌	市場：汰換老舊設備 ● ACME (RF Power System) 節能68% ● 8吋設備汰換商機
半導體設備廠	技術服務	● 半導體設備大廠 全球Ozone主要維修夥伴 ● 維修量能擴產準備
	自有品牌	市場：設計階段導入 ● 國際客戶：CIP商機與明遠價值 ● 國內客戶：先進封裝商機
二手設備廠	技術服務	長期合作夥伴 隨景氣波動
	自有品牌	

連續5季損益

損益表 (NTD K)	114/Q3	114/Q4	115/Q1	115/Q2	115/Q3
營業收入	159,101	169,220	174,545	194,598	189,492
營業毛利率	34%	35%	35%	41%	45%
營業費用	33,110	37,748	35,311	37,646	41,280
營業費用率	21%	22%	20%	19%	22%
營業淨利	20,520	22,190	25,364	42,661	43,101
營業淨利率	13%	13%	15%	22%	23%
業外收支	1,518	6,069	2,699	4,021	3,415
稅前淨利	24,038	28,259	28,063	46,682	46,517
稅後淨利	18,924	23,861	23,729	41,955	37,718
稅後加權EPS	0.56	0.71	0.70	1.24	1.12

Q3營運說明

<營收>
. Q2起全稼動
. 先進製程技術服務小量接單
. 台灣、上海 同步成長

<毛利率>
. ACME⬇ 技術服務⬆
. 高單價品項成長(台灣、上海)
. Cost Down
. 長期目標 40%⬆

<費用率>
. 長期目標20%

2026/Q3 損益表

損益表 (NTD K)	115/Q3	114/Q3	115/1~9	114/1~9	YoY
營業收入	189,497	159,101	558,640	501,852	+ 11%
營業毛利率	45%	34%	40%	32%	⬆ 8%
營業費用	41,280	33,110	114,237	110,471	+ 3%
營業費用率	22%	21%	20%	22%	⬇ 2%
營業淨利	43,102	20,520	111,127	51,162	
營業淨利率	23%	13%	20%	10%	
業外收支	3,415	3,518	10,135	(1,821)	
稅前淨利	46,517	24,038	121,262	49,341	
稅後淨利	37,718	18,924	103,402	45,261	+ 128%
稅後加權EPS	1.12	0.56	3.06	1.35	

2026/Q3 資產負債表

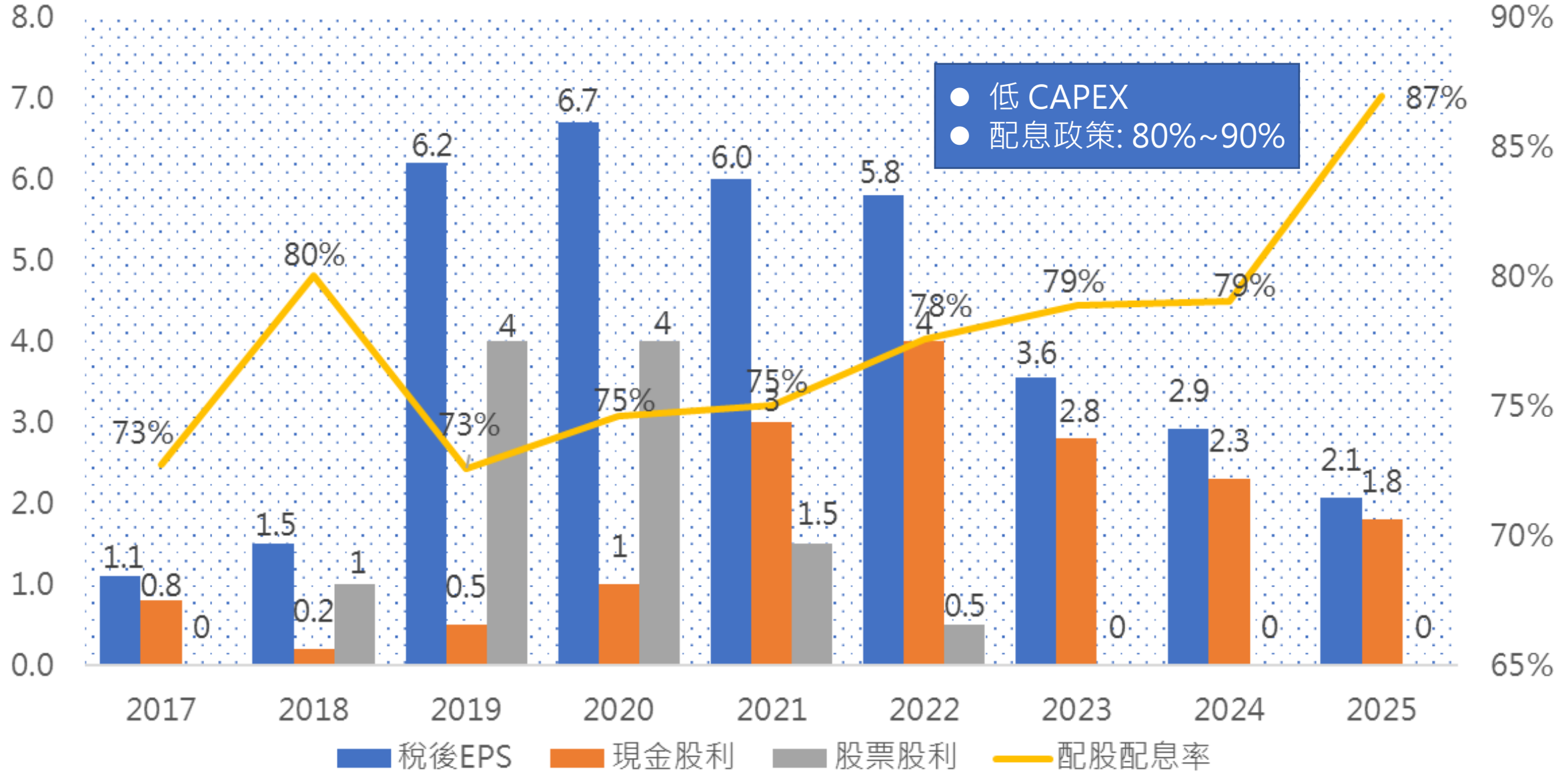
合併資產負債表 (NTD K)	115/09/30	114/12/31	114/09/30
現金 約當現金及金融資產	612,175	556,680	484,869
合約資產	48,443	45,371	39,361
應收帳款、票據	153,753	122,166	129,592
存貨	210,973	235,603	248,335
權益法長投	17,977	19,954	19,214
固定資產	272,542	275,262	275,814
總資產	1,392,349	1,318,109	1,269,775
應付帳款、其他應付款	135,694	106,802	102,498
股本	337,698	337,698	337,448
權益總計	1,208,495	1,164,695	1,127,001
負債比率	13%	12%	11%
每股淨值	35.8	34.5	33.4

存貨下降

2026/Q3 現金流量表

合併現金流量表 (NTD K)	115/1-9	114/1-9
稅前淨利	121,262	49,341
折舊攤銷	21,597	20,291
營業活動淨現金流量	144,387	39,526
轉列定存(金融資產)	(10,000)	(100,000)
Capex(設備/無形資產)	(22,970)	(33,576)
投資活動淨現金流量	(34,497)	(133,214)
借款增(減)	0	0
發放現金股利	(60,786)	(77,288)
現增/員權認購	0	28,728
庫藏股買回	0	(39,428)
籌資活動淨現金流量	(68,687)	(93,428)
Free Cash Flow	109,890	5,950

股利政策


8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
90%
85%
80%
75%
70%
65%
低 CAPEX
配息政策: 80%~90%
1.1
0.8
0
1.5
0.2
1
6.2
0.5
4
6.7
1
4
6.0
3
1.5
5.8
4
0.5
3.6
2.8
0
2.9
2.3
0
2.1
1.8
0
73%
80%
73%
75%
75%
78%
79%
79%
87%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
稅後EPS
現金股利
股票股利
配股配息率

產品與技術

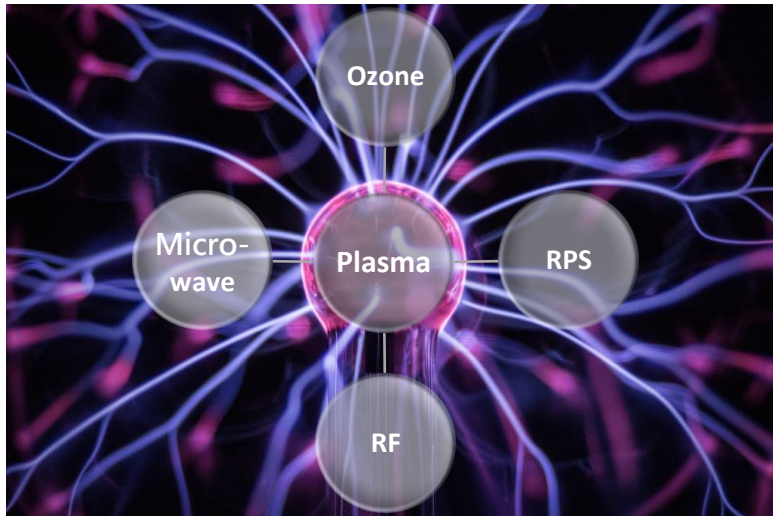
Finesse Technical Role and Focus

明遠是一家

→ 電漿應用技術服務公司

明遠產品跨距

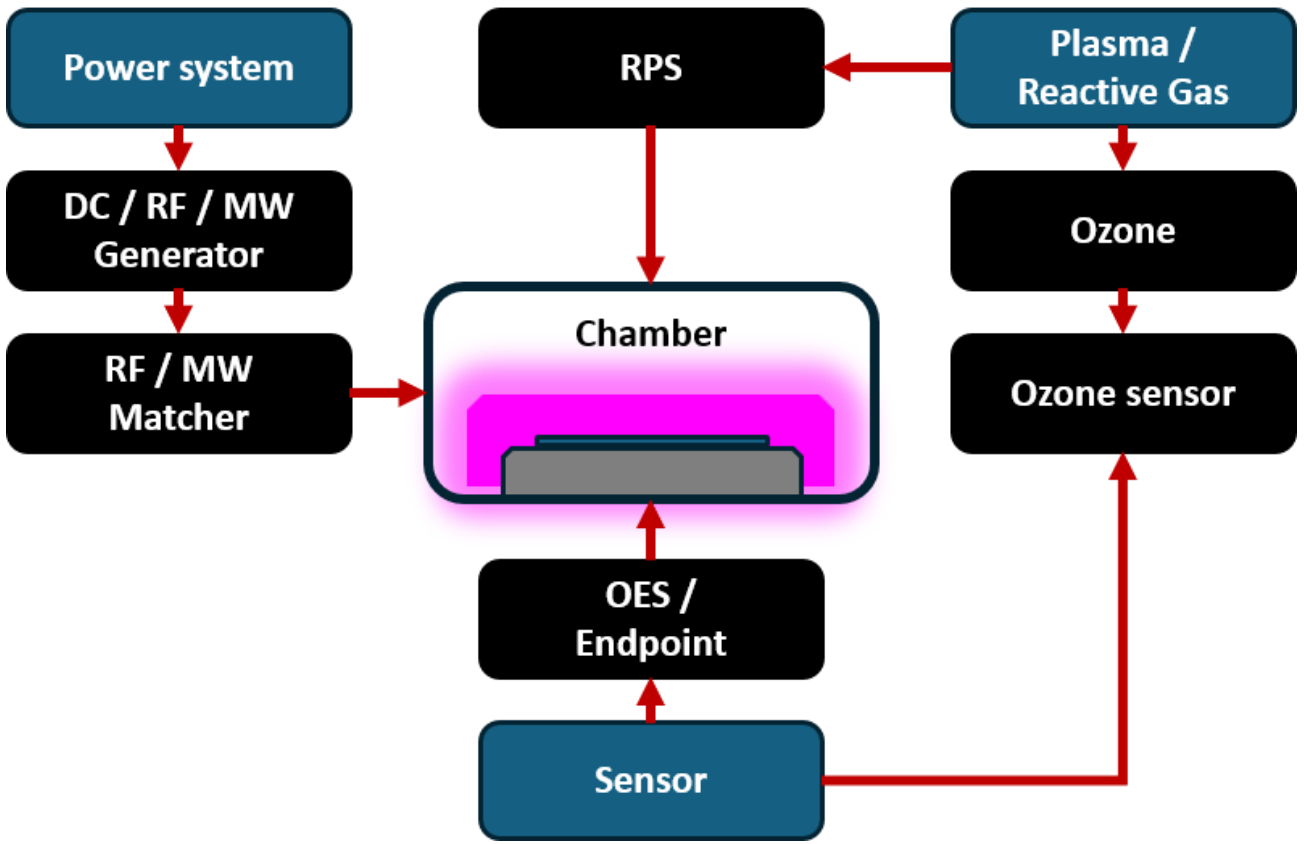
Wafer size: 150mm ~ 300 mm
Process node: > 0.25µm ~ < 2nm ; AP







Key Subsystem provider for wafer process chambers



Plasma / Reactive gas	
Ozone	提供製程所需的反應氣體
RPS	提供製程所需的反應自由基

Power system	
Generator	提供電漿產生所需要的電磁功率
Matcher	讓電磁功率有效率的送進反應腔

Sensor	
Endpoint	偵測製程反應結束時間
Ozone sensor	確認反應氣體的濃度
OES	即時診斷腔體中電漿的狀態

Brand Products Lineup

RF generators / System





ACME for Ultima+
(RPS)

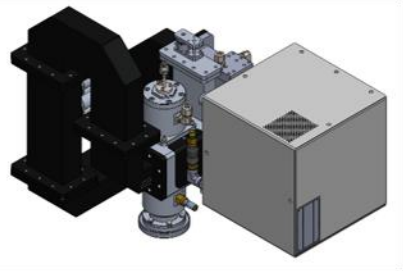


ACME for Ultima
(MW)

Remote plasma source



RPS



MW plasma source

Ozone components / system



Controller



Sensor



Pressure regulator



Destructor



Ozone generator



Ozone system
for ALD



Ozone system
for SACVD



Ozone water system

Technical Capability

		Wafer size	150mm	200mm	300mm					300mm					Advanced package
		Node	>0.25 um	0.11/0.18 um	90 nm	65 nm	40/45 nm	28 nm	16/20 nm	7 nm	5 nm	3 nm	2 nm	<2 nm	
		Technology	Mature process							Advanced process					
Overhaul	Ozone	CVD	■		■					■					■
		ALD					■			■					■
		Wet					■			■					■
	RPS	CVD	■		■					■					■
		ETCH	■		■					■					■
	MW	ETCH	■		■					■					■
	RF	CVD	■												
		ETCH	■		■					■					■
Product	Ozone	CVD	■		■					■					■
		ALD					■			■					■
		Wet					■			■					■
	RPS	CVD	■		■					■					■
		ETCH	■		■					■					■
	MW	ETCH	■		■					■					■
	RF	CVD	■		■										
		ETCH	■		■					■					■

業務與展望

2026成長動能

2026 Q1-Q3

- 台灣、上海 Q2起全稼動
- 重要客戶市占率提升
- 高毛利技服維修成長
- 先進製程技服維修成長
- 除ACME外他自有品牌起量
- 國際客戶營收成長

2026 Q4

- 持續維持全稼動動能
- 重要客戶Ozone持續往上
- 自有品牌買賣成長
- 備品買賣成長
- 瓶頸：產能、人力、場地

未來展望

✓ 基本盤

- 新廠設備陸續過保--展望2027年技術服務持續成長
- 明遠技術涵蓋【>25um~<2nm製程範圍】
- 2027 ACME 及他自有品牌買賣成長

✓ 業務面

- 技術服務：12” 先進製程Ozone/ RPS接單持續放量
- 自有產品： 8”/12” 老舊設備汰換商機、12” 先進封裝設備

✓ 擴產計畫

- 日本、上海、台灣

✓ 財務面

- 配息率 80%~90%
- 尋求投資與併購機會


THANK
YOU